

2024 年 06 月 10 日

电子

行业周报

证券研究报告

# WSTS 上调半导体市场预期，WWDC/COMPUTEX 引领端侧 AI 落地

投资评级 **领先大市-A**  
维持评级

目 半导体行业有望持续复苏，国内半导体设备销售额大幅增长：

WSTS 最新预测上调 2024 年全球半导体市场规模至 6112 亿美元，同比增长 16%，预计 2025 年将继续增长 12.5% 至 6874 亿美元。此次修订是 WSTS 调整后的 2024 年春季预测的一部分，反映了过去两个季度的强劲表现，尤其是在计算终端市场。逻辑器件和存储器需求预计将持续引领半导体市场增长，24/25 年同比增速将分别达到 10.7% 和 76.8%/10.4% 和 25.2%。按地区来看，2024 年美洲和亚太地区预计分别实现 25.1% 和 17.5% 增长，欧洲增长 0.5%，而日本预计将下降 1.1%，2025 年所有地区均将实现增长。SEMI 最新报告显示，24Q1 全球半导体设备销售额 264 亿美元，同比下降 2%，其中中国大陆市场销售额达到 125.2 亿美元，同比增长 113%，连续四个季度成为全球最大半导体设备市场。

目 苹果全球开发者大会召开在即，AI 创新有望带动产业链发展：

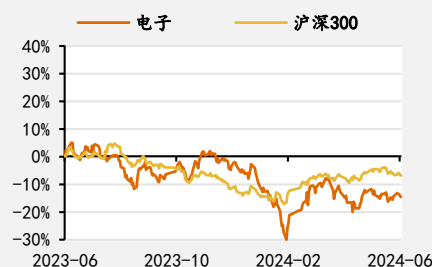
2024 年苹果全球开发者大会（WWDC24）将于北京时间 6 月 11-15 日举行，预计将推出一系列 AI 功能。本次大会苹果将发布新一代 iOS 18 操作系统，彭博社马克古尔曼表示，苹果已经与 OpenAI 达成协议，在 iOS 18 中引入 ChatGPT，升级更为智能的 Siri；苹果还将提供一系列生成式 AI 功能，包括自动生成表情符号、自动生成邮件/短信回复内容等。苹果可能在 WWDC24 上推出一套全新的 AI 工具方案，项目名称为 Project Greymatter，主要面向 Safari、Photos 和 Notes 等核心应用和部分操作系统功能。Project Greymatter 将采用云端和边缘终端相结合的混合 AI 模式，并有望在 iOS 18 和 macOS 15 中实现应用。今年 2 月，苹果宣布放弃造车项目，全面转向生成式 AI 领域，整体来看战略上对 AI 倾斜，建议关注产业链投资机会。

目 AI PC 成为 COMPUTEX 2024 焦点，有望开启新一轮换机周期：

6 月 4 日，台北国际电脑展（COMPUTEX 2024）拉开帷幕，众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等均发表演讲，其中大量与 AI PC 相关。高通于去年 10 月和今年 4 月陆续推出骁龙 X Elite 和骁龙 X Plus，目前首批搭载这两款芯片的 PC 超过 20 款，品牌厂商包括宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、surface、三星等。AMD 发布了第三代 AI PC 芯片“锐龙 AI 300 系列”，其 NPU 算力可提升 3 倍，达到 50TOPS，为当前最强 NPU，此外还发布了采用 Zen5 架构的 AMD Ryzen 9000 系列桌面处理器，第一批产品将于 7 月上市。英特尔 CEO 基辛格宣布面向 AI PC 的旗舰产品的 Lunar Lake 的处理器将在 Q3 大规模出货。英伟达 CEO 黄仁勋宣布下一代 GPU 架构 Rubin，新 GPU 将首次支持 8

首选股票 目标价（元） 评级

行业表现



资料来源：Wind 资讯

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	-0.4	-2.9	-9.1
绝对收益	-2.7	-1.6	-14.8

马良 分析师

SAC 执业证书编号：S1450518060001

maliang2@essence.com.cn

相关报告

大基金三期成立，半导体国产替代有望加速	2024-06-02
英伟达业绩/指引超预期，微软新 Surface 打响 Copilot+PC 第一枪	2024-05-26
GPT-4o/Gemini 推动端侧 AI 落地，玻璃基板封装有望加速渗透	2024-05-19
中芯/华虹业绩超指引，AI 有望赋能苹果终端	2024-05-12
新能源汽车产业景气上行，半导体掩膜板国产化需求强劲	2024-05-05

层 HBM4 的高带宽存储，升级版 Rubin Ultra 将支持 12 层 HBM4。与传统 PC 相比，AI PC 在硬件上带来多项升级，包括处理器、存储、散热等，从而可以更好地管理 AI 工作负载，高效能、低功耗，大幅提升笔记本的续航能力，配合大模型的运行。据 Canalys 数据显示，24Q1 全球 PC 市场呈增长态势，台式机和笔记本电脑的总出货量达 5720 万台，同比增长 3.2%，反映出 PC 需求在各个领域持续小幅回暖。Canalys 预计受益于 Windows 11 的更新和 AI PC 的发展，PC 市场将在全年加速增长，2024-2028 年全球 AI PC 出货量将从 0.51 亿台提升至 2.08 亿台，年复合增长率达到 42.11%，渗透率将从 19% 提升至 71%。

#### 目 电子本周跌幅-0.46% (5/31)，10 年 PE 百分位为 29.96%：

(1) 本周 (2024.06.03-2024.06.07) 上证综指下降 1.15%，深证成指下降 1.16%，沪深 300 指数下降 0.16%，申万电子板块下降 0.46%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 5/31。2024 年，电子板块累计下降 12.29%。(2) 半导体设备在电子行业子板块中涨幅最高，为 7.40%；品牌消费电子跌幅最大，为-5.86%。(3) 电子板块涨幅前三公司分别为协和电子(+61.09%)、逸豪新材(+54.66%)、贝仕达克(+50.67%)，跌幅前三公司分别为退市碳元(-83.84%)、联建光电(-27.68%)、万祥科技(-27.42%)。(4) PE：截至 2024.06.07，沪深 300 指数 PE 为 11.63 倍，10 年 PE 百分位为 39.50%；SW 电子指数 PE 为 36.44 倍，10 年 PE 百分位为 29.96%。

#### 目 投资建议：

半导体设备零部件建议关注北方华创、中微公司、中科飞测、华海清科、万业企业、富创精密、芯源微、新莱应材；半导体材料建议关注路维光电、清溢光电、鼎龙股份、雅克科技、晶瑞电材、华特气体、彤程新材、华海诚科等；苹果产业链建议关注立讯精密、鹏鼎控股、领益智造、兆易创新等；AI PC 产业链建议关注芯海科技、龙芯中科、澜起科技、聚辰股份、春秋电子等。

#### 目 风险提示：

下游需求不及预期风险；技术迭代不及预期风险；国际科技博弈力度加大风险。

## 目 录

1. 本周新闻一览.....	4
2. 行业数据跟踪.....	5
2.1. 半导体: WSTS 预计全球半导体市场 24/25 年 YoY+16.0%/+12.5%.....	5
2.2. SiC: 英飞凌 50 亿欧元功率半导体工厂获最终许可.....	7
2.3. 消费电子: 智能手机市场温和复苏, 24 年 AI 手机渗透率有望达 16%.....	8
3. 本周行情回顾.....	9
3.1. 涨跌幅: 电子排名 5/31, 子板块中半导体设备涨幅最高.....	9
3.2. PE: 电子指数 PE 为 36.44 倍, 10 年 PE 百分位为 29.96%.....	10
4. 本周新股.....	12

## 目 录

图 1. 2023-2025E 全球半导体市场销售额及同比增速 (分地区、分产品).....	5
图 2. 台积电月度营收.....	5
图 3. 世界先进月度营收.....	5
图 4. 联电月度营收.....	6
图 5. 新能源汽车产销量情况.....	7
图 6. 光伏装机情况.....	7
图 7. 国内智能手机月度出货量.....	8
图 8. 国内智能手机月度产量.....	8
图 9. Steam 平台主要 VR 品牌市场份额.....	8
图 10. Steam 平台 VR 月活用户占比.....	8
图 11. 本周各行业板块涨跌幅 (申万一级行业分类).....	9
图 12. 本周电子板块子板块涨跌幅 (申万二级行业分类; %).....	9
图 13. 本周电子板块子板块涨跌幅 (申万三级行业分类).....	9
图 14. 本周电子板块涨幅前十公司 (%).....	10
图 15. 本周电子板块跌幅前十公司 (%).....	10
图 16. 电子板块近十年 PE 走势.....	10
图 17. 电子板块近十年 PE 百分位走势.....	11
图 18. 电子板块子板块近十年 PE 走势.....	11
图 19. 电子板块子板块近十年 PE 百分位走势.....	11
表 1: 本周电子行业新闻一览.....	4
表 2: 本周 IPO 审核状态更新.....	12
表 3: 本周重点 IPO 动态.....	12

## 1. 本周新闻一览

表1：本周电子行业新闻一览

赛道	日期	来源	内容
半导体	6月3日	快科技	ASML：宣布携手比利时微电子研究中心在荷兰开设联合 High-NA EUV 光刻实验室，并由双方共同运营。该实验室可提供 High NA EUV 扫描仪及周边处理工具。声明称，该实验室的启用是为大批量生产 High NA EUV 做准备，预计将于 2025-2026 年实现大批量生产。
	6月5日	半导体行业观察	WSTS：预计 2024 年全球半导体市场将达到 6110 亿美元，同比增长 16%。其中，美洲和亚太地区预计分别实现 25.1% 和 17.5% 增长；逻辑器件和存储器预计分别实现 10.7% 和 76.8% 增长。2025 年所有地区及产品类别均将继续扩张。
	6月5日	半导体芯闻	世界先进：宣布将与恩智浦成立合资子公司 VSMC，计划于新加坡兴建运营首座 12 吋晶圆厂。目标 2024 年下半年兴建、2027 年量产。晶圆厂将采用 130 纳米至 40 纳米的技术，生产包括混合讯号、电源管理和模拟产品，以支援汽车、工业、消费性电子及移动设备等终端市场需求，相关技术授权及技术转移预计来自最大法人股东台积电。
	6月6日	财联社	ASML：ASML 首席财务官 Roger Dassen 称将于第二、三季度开始获得台积电“大量”（significant）2 纳米相关订单。公司两大客户台积电和英特尔将在今年年底前获得所谓的高数值孔径（高 NA）极紫外（EUV）光刻系统。
	6月7日	IT之家	SEMI：24Q1 全球半导体设备销售额 264 亿美元，同比下降 2%，其中中国台湾、北美市场销售额大减，而中国大陆市场销售额达到 125.2 亿美元，同比增长 113%，连续四个季度成为全球最大半导体设备市场。
AI	6月4日	集微网	台北国际电脑展：AMD 发布 AI PC 芯片锐龙 AI 300 系列，NPU 算力达到 50TOPS，同时发布采用 Zen5 架构的 AMD Ryzen 9000 系列桌面处理器，第一批产品将于 7 月上市；此外还宣布将于 2025 年推出 MI350，采用 3nm 制程，与台积电合作。英特尔 CEO 基辛格宣布 Lunar Lake 处理器将在 Q3 大规模出货。英伟达 CEO 黄仁勋宣布下一代 GPU 架构 Rubin，新 GPU 将首次支持 8 层 HBM4 的高带宽存储，升级版 Rubin Ultra 将支持 12 层 HBM4。
	6月6日	芯智讯	英特尔：推出首款配备能效核的英特尔至强 6（Xeon 6）处理器产品。至强 6 处理器拥有最高 144 个 E 核，与第五代英特尔至强相比，能效提升了 20%-66%，为高密度、横向扩展工作负载带来性能与能效的双重提升。
SiC	6月3日	全球半导体观察	英飞凌：公司已获得其位于德国德累斯顿的价值 50 亿欧元的智能功率半导体工厂的最终建设许可。该工厂按计划将于 2026 年开始生产，主要用于生产模拟/混合信号和功率类产品，将创造大约 1000 个高素质工作岗位，新工厂旨在增强欧洲的供应链安全。
	6月6日	安森美官微	安森美：推出 T10 PowerTrench 系列和 EliteSiC 650V 解决方案，提供了卓越的开关性能和更低的器件电容。该方案可使数据中心减少约 1% 的电力损耗，如果在全球的数据中心实施这一解决方案，每年可以减少约 10 太瓦时的能源消耗。
汽车电子	6月4日	财政部官网	财政部：发布《关于下达 2024 年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》，汽车以旧换新补贴年度资金总额为 112 亿元。其中，中央资金 64.4 亿元，地方资金 47.6 亿元。绩效指标方面，全年报废汽车回收量 378 万辆。
	6月6日	电子工程专辑	大基金：据天眼查 APP 显示，近日长电科技汽车电子有限公司发生工商变更，新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司等为股东，同时公司注册资本由 4 亿元增加至 48 亿元。
消费电子	6月4日	芯智讯	IDC：预计 2024 年全球个人电脑（PC）销量可能仅与去年的 2.602 亿台持平。IDC 认为 AI PC 有望提升 PC 的平均销售单价，但长期而言难带动销量大幅度成长。此外 IDC 预估 AI PC 在今年整体 PC 销量当中的占比将达到 20%，并有望于 2028 年增长至超过三分之二。
	6月6日	Canalys 官微	Canalys：预计 2024 年全球智能手机出货量将复苏 3% 至 11.8 亿台。区域层面，成熟市场的复苏力度仍较缓，新兴市场复苏节奏较快，但厂商拥挤程度正在加剧。长期来看，2024 年至 2028 年全球智能手机出货量复合增长率为 2%。
存储	6月6日	SK 中国	SK 海力士：集团会长崔泰源会见了台积电新任董事长魏哲家，双方同意加强在 AI 芯片方面的合作。公司计划以该合作为基础，从 2025 年开始批量生产 HBM4，使用台积电的 Logic 领先工程，以提高产品性能。
	6月7日	半导体芯闻 IT之家	SK 海力士：首度参展 COMPUTEX 2024，展出最新 HBM3E 记忆体以及 MR-MUF 技术，并透露芯片堆叠上 Hybrid bonding 将成为很重要的一环。此外公司还携手 HLDS，推出了合作打造的消费级存储品牌 Super Multi，针对更为大众的主流市场，展示了多款基于 SK 海力士颗粒打造的存储硬件，包括 DDR4 SODIMM、UDIMM 内存模组和 SATA、M.2 固态硬盘等。

资料来源：国投证券研究中心整理

## 2. 行业数据跟踪

### 2.1. 半导体：WSTS 预计全球半导体市场 24/25 年 YoY+16.0%/+12.5%

世界半导体贸易统计组织(WSTS)最新预测显示,2024年全球半导体市场将达到6112亿美元,同比增长16%。此次修订是WSTS调整后的2024年春季预测的一部分,反映了过去两个季度的强劲表现,尤其是在计算终端市场。2024年,预计逻辑器件和存储器将推动全年增长,同比增长分别达到10.7%和76.8%,而分立器件、光电子器件、传感器和模拟半导体预计将出现个位数下降;美洲和亚太地区预计分别实现25.1%和17.5%增长,欧洲增长0.5%,而日本预计将下降1.1%。2025年,全球半导体市场将达到6874亿美元,同比增长12.5%,持续由逻辑器件和存储器增长推动,其他产品类别均将实现个位数增长,所有地区均将继续扩张。

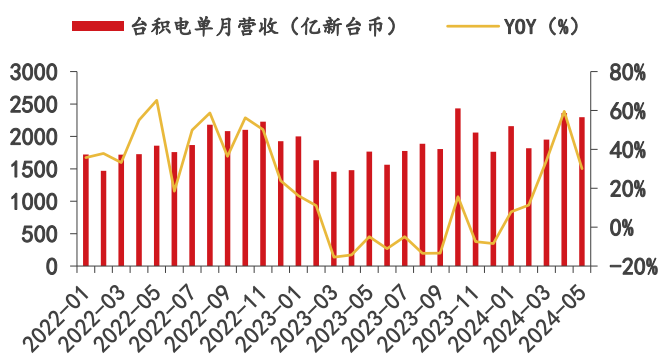
图1. 2023-2025E 全球半导体市场销售额及同比增速 (分地区、分产品)

Spring 2024	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Americas	134,377	168,062	192,941	-4.8	25.1	14.8
Europe	55,763	56,038	60,901	3.5	0.5	8.7
Japan	46,751	46,254	50,578	-2.9	-1.1	9.3
Asia Pacific	289,994	340,877	382,961	-12.4	17.5	12.3
<b>Total World - \$M</b>	<b>526,885</b>	<b>611,231</b>	<b>687,380</b>	<b>-8.2</b>	<b>16.0</b>	<b>12.5</b>
Discrete Semiconductors	35,530	32,773	35,310	4.5	-7.8	7.7
Optoelectronics	43,184	42,736	44,232	-1.6	-1.0	3.5
Sensors	19,730	18,265	19,414	-9.4	-7.4	6.3
Integrated Circuits	428,442	517,457	588,425	-9.7	20.8	13.7
Analog	81,225	79,058	84,344	-8.7	-2.7	6.7
Micro	76,340	77,590	81,611	-3.5	1.6	5.2
Logic	178,589	197,656	218,189	1.1	10.7	10.4
Memory	92,288	163,153	204,281	-28.9	76.8	25.2
<b>Total Products - \$M</b>	<b>526,885</b>	<b>611,231</b>	<b>687,380</b>	<b>-8.2</b>	<b>16.0</b>	<b>12.5</b>

资料来源: WSTS, 国投证券研究中心

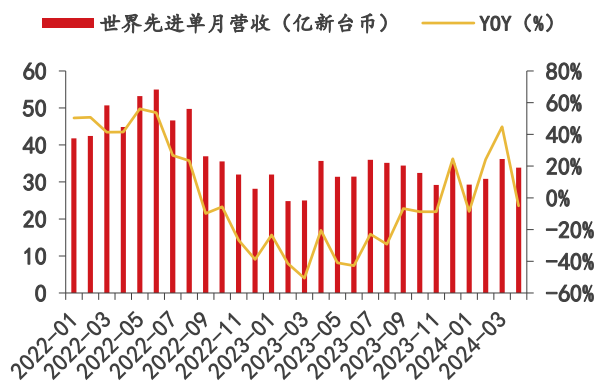
2024年5月台积电单月营收2296.20亿新台币,同比增长30.07%,环比下降2.71%。世界先进2024年4月营收33.88亿新台币,同比下降5.07%,环比下降6.42%。联电2024年5月营收195.09亿新台币,同比增长3.89%,环比下降1.18%。

图2. 台积电月度营收



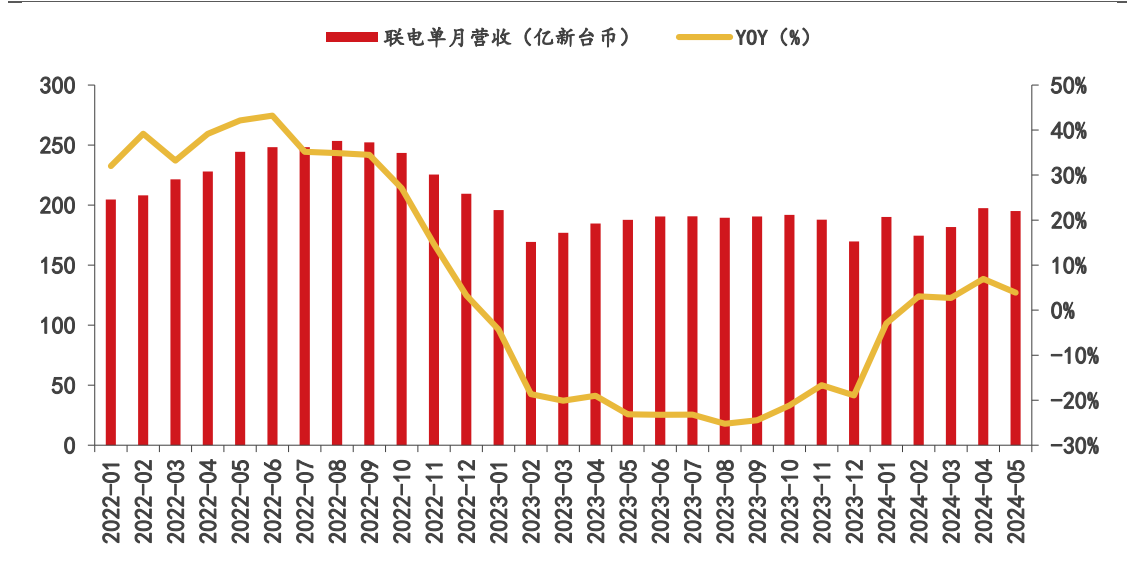
资料来源: 台积电公司官网, 国投证券研究中心

图3. 世界先进月度营收



资料来源: 世界先进公司官网, 国投证券研究中心

图4. 联电月度营收



资料来源：联电公司官网，国投证券研究中心

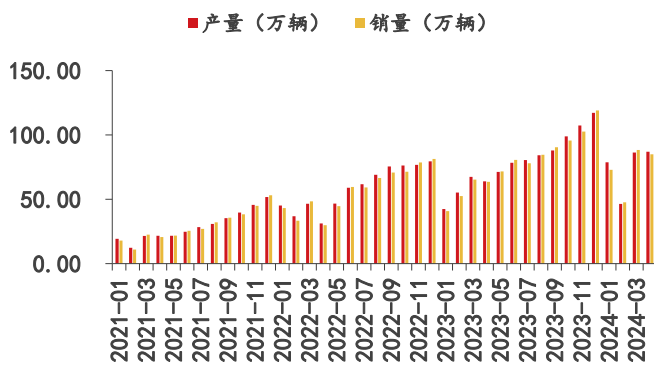
## 2.2. SiC: 英飞凌 50 亿欧元功率半导体工厂获最终许可

6 月 3 日，英飞凌最新消息显示，公司已获得其位于德国德累斯顿的智能功率半导体工厂的最终建设许可。工厂价值 50 亿欧元，该笔投资是英飞凌历史上最大的单笔投资。工厂按计划将于 2026 年开始生产，主要用于生产模拟/混合信号和功率类产品，将创造大约 1000 个高素质工作岗位，新工厂旨在增强欧洲的供应链安全。此前英飞凌表示，位于奥地利菲拉赫工厂的碳化硅产能正在爬坡中，预估到 2025 年营收可达 10 亿欧元。公司希望随着马来西亚的居林超级工厂在 2024 年底投产，最终带动其碳化硅营收于 2030 年达到 70 亿欧元，并占据全球 30% 碳化硅器件市场份额。

由中汽协公布的新能源车产销量数据，2024 年 4 月，国内新能源汽车产量由去年 64.0 万辆增长至 87.0 万辆，销量由去年 63.6 万辆增长至 85.0 万辆。4 月产销量仍保持同比增长，汽车消费端动能不减。

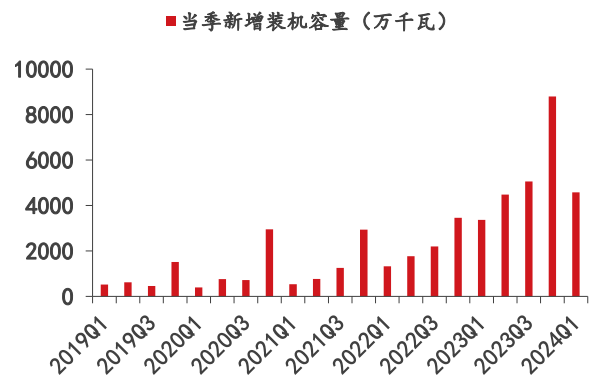
光伏方面，国内近年来季度光伏安装量增长迅速，据国家能源局发布的全国电力工业统计数据，2024Q1 国内光伏新增装机达到 45.74GW，环比减少 47.99%，同比增长 35.89%。光伏产业的迅速发展同样能够带动对第三代半导体（碳化硅）功率器件的需求。

图5. 新能源汽车产销量情况



资料来源：中国汽车工业协会，Wind，国投证券研究中心

图6. 光伏装机情况



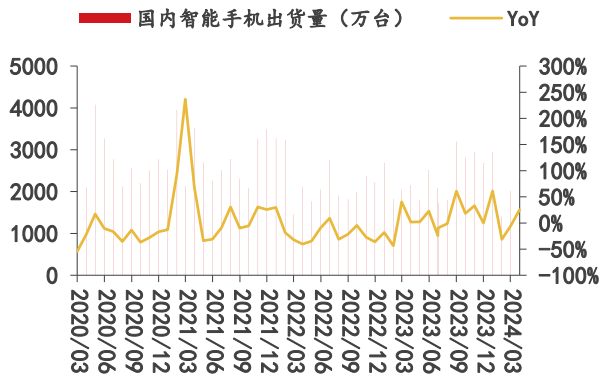
资料来源：国家能源局，国投证券研究中心

### 2.3. 消费电子：智能手机市场温和复苏，24 年 AI 手机渗透率有望达 16%

6 月 6 日，Canalys 预计受供需两端恢复的推动，2024 年全球智能手机出货量将复苏 3%至 11.8 亿台。区域层面，成熟市场的复苏力度仍较缓，新兴市场复苏节奏较快，但厂商拥挤程度正在加剧。长期来看，2024-2028 年全球智能手机出货量年复合增长率预计为 2%。AI 手机方面，苹果 24Q1 AI 手机出货达 2700 万台，占 57% 的市场份额，凭借在高端市场的优势，市占第一；此外，第二名三星 24Q1 AI 手机出货 1360 万台（29%），第三名小米出货 200 万台（4%），第四、五名分别为 vivo 170 万（4%）和 OPPO 150 万（3%）。Canalys 预计 2024 年全球 AI 手机的渗透率将达到 16%。

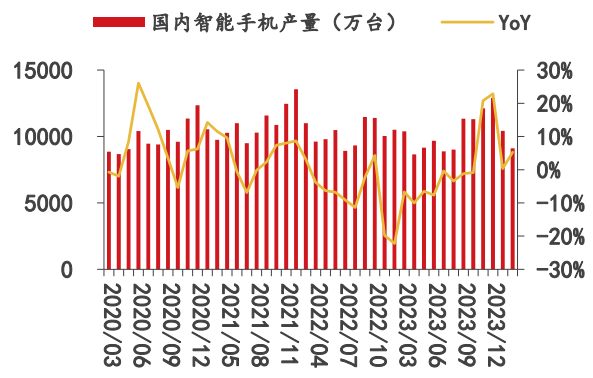
**智能手机：**据中国信通院，2024 年 4 月中国智能手机出货量为 2266.80 万台（YoY+25.5%，MoM+12.1%）；据国家统计局，2024 年 4 月中国智能手机产量为 9104 万台（YoY+5.3%，MOM-12.6%）。

图7. 国内智能手机月度出货量



资料来源：Wind，中国信通院，国投证券研究中心

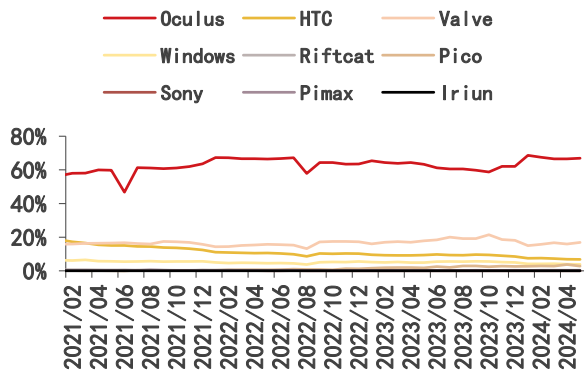
图8. 国内智能手机月度产量 (万台) 及 YoY 增长率



资料来源：Wind，国家统计局，国投证券研究中心

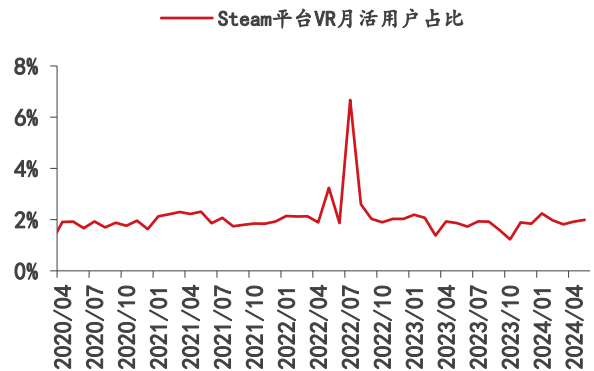
**VR：**据 Steam，2024 年 5 月 Oculus 在 Steam 平台的份额占比为 66.87%，YoY+3.54pct，MoM+0.36pct，而 Pico 份额占比为 2.79%，YoY+0.97pct，MoM-0.96pct；Steam 平台 VR 月活用户占比为 1.99%，YoY+0.12pct，MoM+0.07pct。

图9. Steam 平台主要 VR 品牌市场份额



资料来源：Steam，国投证券研究中心

图10. Steam 平台 VR 月活用户占比



资料来源：Steam，国投证券研究中心

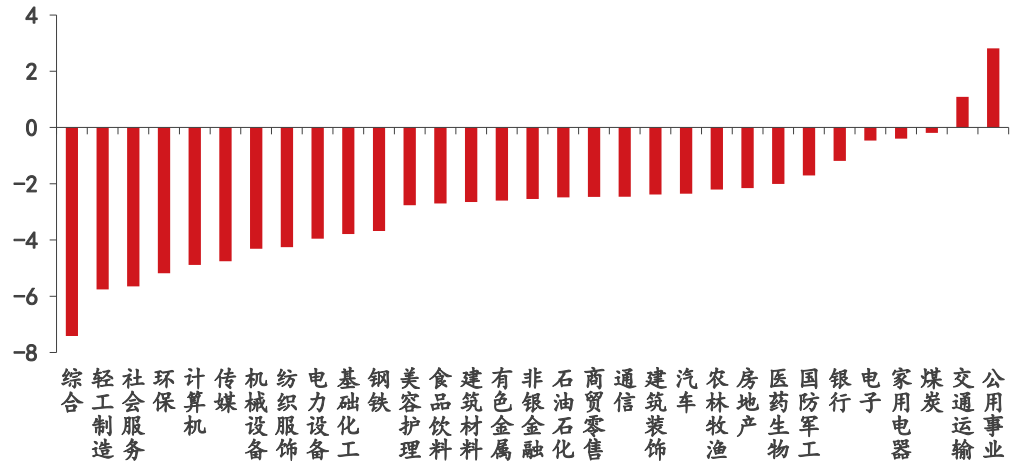


### 3. 本周行情回顾

#### 3.1. 涨跌幅：电子排名 5/31，子板块中半导体设备涨幅最高

- 全行业：本周（2024.06.03-2024.06.07）上证综指下降 1.15%，深证成指下降 1.16%，沪深 300 指数下降 0.16%，申万电子板块下降 0.46%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 5/31。2024 年，电子板块累计下降 12.29%。

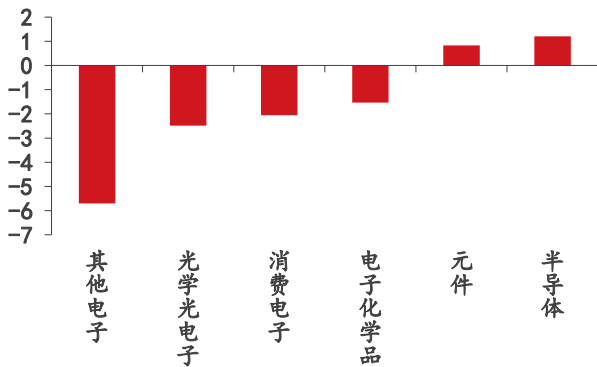
图11. 本周各行业板块涨跌幅（申万一级行业分类）



资料来源：Wind，国投证券研究中心

- 电子行业：本周（2024.06.03-2024.06.07）半导体在电子行业子板块中涨幅最高，为 1.21%；其他电子涨幅最低，为-5.70%；进一步细分来看，半导体设备在电子行业子板块中涨幅最高，为 7.40%；品牌消费电子跌幅最大，为-5.86%。

图12. 本周电子板块子板块涨跌幅（申万二级行业分类；%）



资料来源：Wind，国投证券研究中心

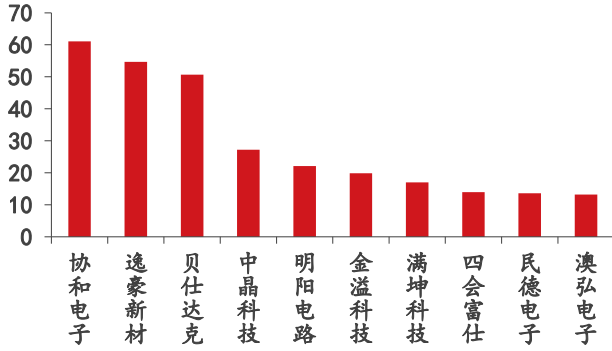
图13. 本周电子板块子板块涨跌幅（申万三级行业分类）

申万二级行业名称	周涨跌幅 (%)	申万三级行业名称	周涨跌幅 (%)
半导体	1.21	分立器件	-3.24
		半导体材料	0.83
		数字芯片设计	-0.59
		模拟芯片设计	-2.18
		集成电路封测	2.85
		半导体设备	7.40
元件	0.83	印制电路板	1.44
		被动元件	-0.51
光学光电子	-2.49	面板	-0.71
		LED	-5.30
		光学元件	-4.84
其他电子	-5.70	其他电子	-5.70
消费电子	-2.06	品牌消费电子	-5.86
		消费电子零部件及组装	-1.48
电子化学品	-1.53	电子化学品	-1.53

资料来源：Wind，国投证券研究中心

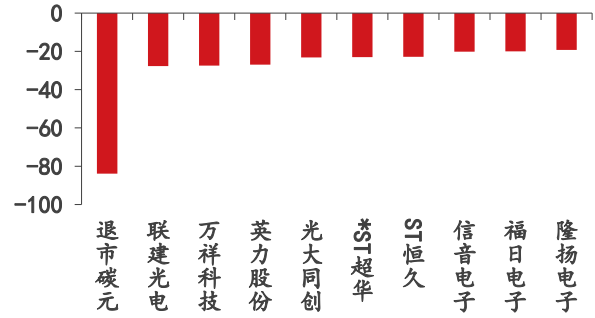
- **电子标的：**本周（2024.06.03-2024.06.07）电子板块涨幅前三公司分别为协和电子（+61.09%）、逸豪新材（+54.66%）、贝仕达克（+50.67%），跌幅前三公司分别为退市碳元（-83.84%）、联建光电（-27.68%）、万祥科技（-27.42%）。

图14. 本周电子板块涨幅前十公司（%）



资料来源：Wind，国投证券研究中心

图15. 本周电子板块跌幅前十公司（%）

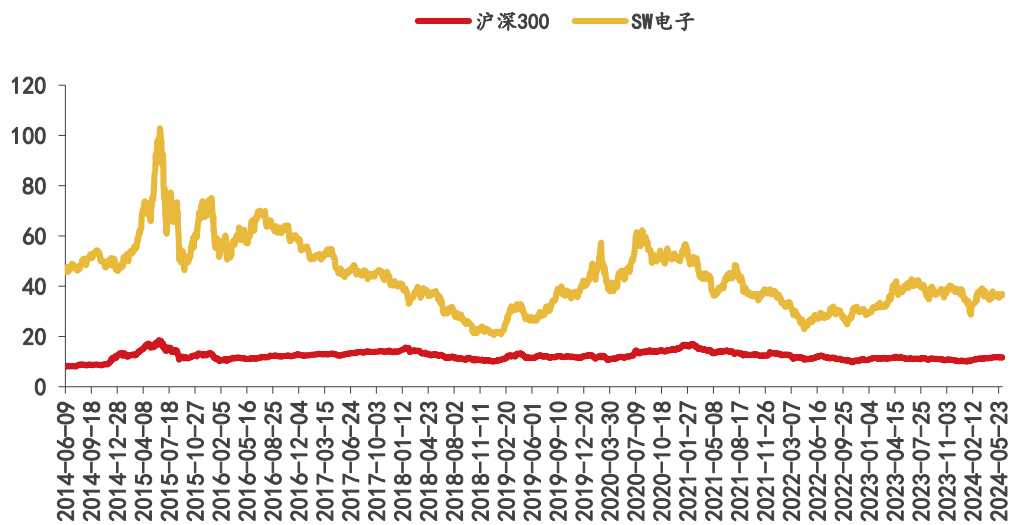


资料来源：Wind，国投证券研究中心

### 3.2. PE：电子指数 PE 为 36.44 倍，10 年 PE 百分位为 29.96%

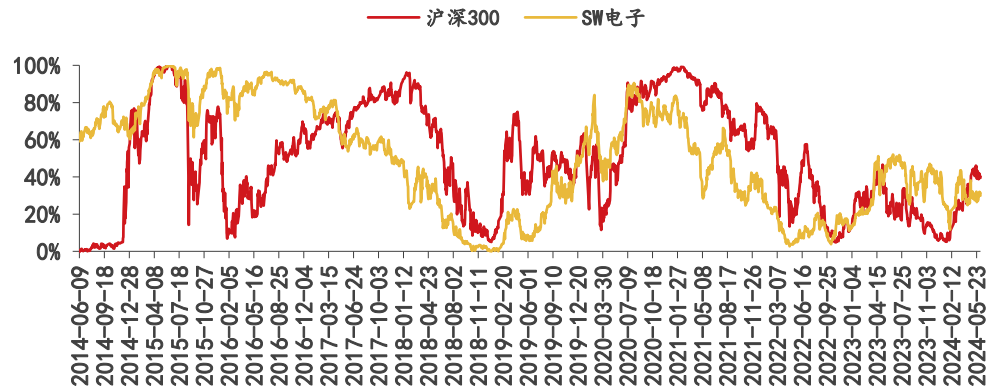
- **电子行业：**截至 2024.06.07，沪深 300 指数 PE 为 11.63 倍，10 年 PE 百分位为 39.50%；SW 电子指数 PE 为 36.44 倍，10 年 PE 百分位为 29.96%。

图16. 电子板块近十年 PE 走势



资料来源：Wind，国投证券研究中心

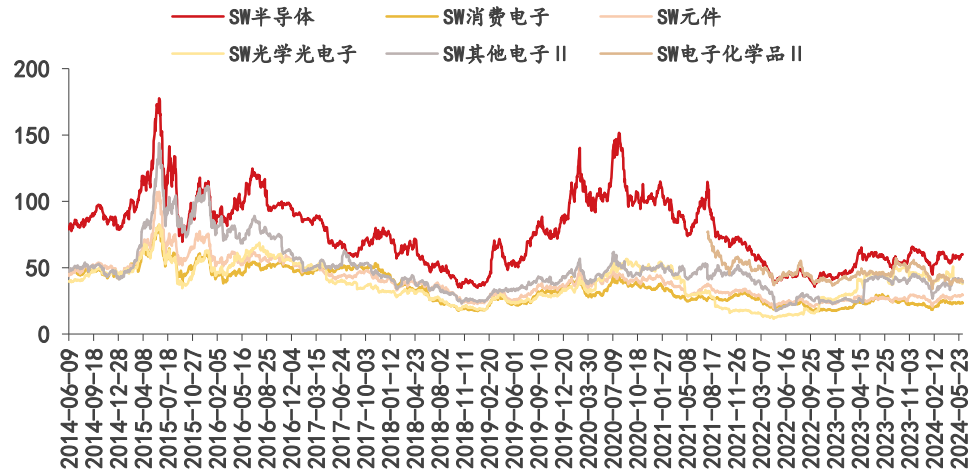
图17. 电子版块近十年 PE 百分位走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

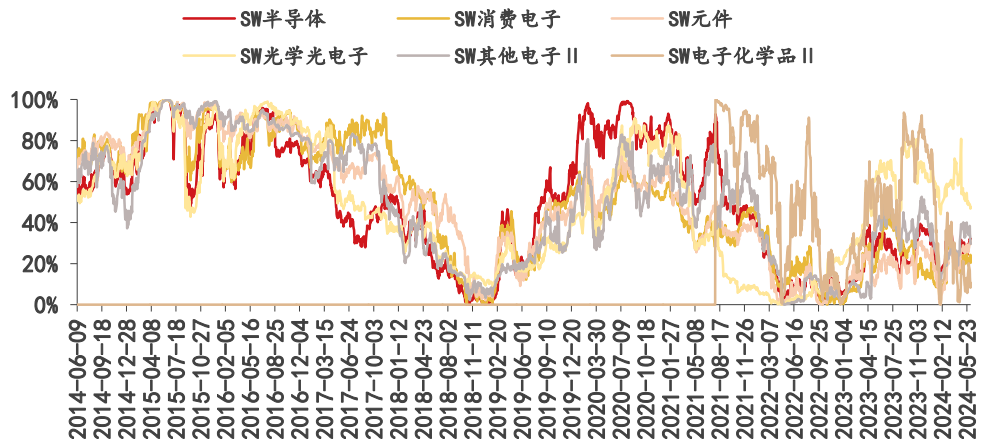
- **电子行业子版块:** 截至 2024. 06. 07, 子行业子版块 PE/PE 百分位分别为半导体 (60. 01 倍/31. 81%)、消费电子 (23. 27 倍/20. 43%)、元件 (29. 38 倍/29. 59%)、光学光电子 (38. 06 倍/47. 39%)、其他电子 (38. 96 倍/29. 68%)、电子化学品 (39. 97 倍/10. 58%)。

图18. 电子版块子版块近十年 PE 走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

图19. 电子版块子版块近十年 PE 百分位走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

## 4. 本周新股

表2：本周 IPO 审核状态更新

	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7
已受理					
已问询				汉朔科技、凯普林	
已回复					
已审核通过					
报送证监会					
证监会注册				慧翰股份	
正在发行					

资料来源：Wind，国投证券研究中心

表3：本周重点 IPO 动态

### 慧翰股份

#### 公司简介

公司的主营业务是为智能物联网、特别是车联网市场，提供无线通信产品、嵌入式软件和整体解决方案，主导产品车联网智能终端（T-BOX）是《国家车联网产业标准体系建设指南》列出的关键零部件。智能网联汽车产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业，已成为汽车强国的战略选择。公司的核心业务是为车联网（智能网联汽车）提供新一代电子电气架构的核心产品和服务，具体包括：前装汽车级 T-BOX、汽车级无线通信模组、智能汽车计算平台、车联网技术服务等，主导产品 T-BOX 通过搜集、分析汽车总线信号及远程通信，实现远程诊断和查询、车身控制、安防服务、互联网应用、软件空中升级（FOTA）、汽车数字钥匙、V2X 通信等功能。同时公司还利用汽车级物联网的技术开发优势拓展其他产业的物联网通信模组业务。公司是国内少数几家能同时为整车企业提供前装 T-BOX、汽车级通信模组及技术服务的企业之一，在国内车载信息通信领域享有较高的知名度，并率先打破国际大型汽车电子厂商对于汽车级 T-BOX 及通信模组的垄断。市场覆盖全球 20 多个国家，合作伙伴包括上汽、北汽、吉利、奇瑞、大众、丰田、通用等国内外一线汽车主机厂及 CATL、德赛西威、电装、弗吉亚、Microchip、SierraWireless 等全球行业龙头企业。

#### 赛道分析

车联网是物联网技术在智能交通系统领域的延伸，车联网也被认为是物联网体系中最有产业潜力、市场需求最明确的领域之一。随着通信技术、信息技术和汽车工业的发展，智能网联汽车（车联网）已经成为未来汽车的发展趋势。全球范围，汽车网联化催生的车联网产业已经成为包括美、欧、亚等汽车发达国家或地区的重要战略性方向，各国家和地区纷纷加快产业布局、制定发展规划，通过政策法规、技术标准、示范建设等全方位措施，推进车联网的产业化进程。2019 年 12 月，工业和信息化部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见稿）提出，到 2025 年，新能源汽车新车销量占比达到 25% 左右，智能网联汽车新车销量占比达到 30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

目前在车联网嵌入式平台系统上主要竞争来自于国外企业，如 Bosch（博世）、Continental（大陆）、Harman（哈曼）、Marelli（马瑞利）、Peiker（佩科）等欧美企业，Denso、LG 等日韩企业。慧翰股份作为国内最早从事 T-BOX 开发的企业，产品已经过四次迭代，近期还启动了 5G 和 V2X 项目开发；作为中国知名的车联网产品提供商，在 2019 年获得国内首份符合 UN-R144 标准的 e-Call 证书。T-BOX 产品已搭载在国内上汽、北汽、一汽、上汽通用五菱、宝沃、奇瑞、观致、吉利等主流车厂的数十款车型。

#### 募投项目

序号	募投金额（万元）	建设期	项目名称
1	23,984.00	39 个月	5G 车联网 T-BOX 研发产品及产业化项目
2	19,355.00	39 个月	研发中心建设项目
3	9,800.00	-	补充流动资金
<b>合计金额</b>	<b>53,139.00</b>		

#### 财务表现

（亿元）	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
营业收入	-	4.22	5.80	8.13
归母净利润	-	0.59	0.86	1.28

资料来源：Wind，国投证券研究中心整理

## 目 行业评级体系

收益评级:

领先大市 —— 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%及以上;

同步大市 —— 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%;

落后大市 —— 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%及以上;

风险评级:

A —— 正常风险, 未来 6 个月的投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动;

B —— 较高风险, 未来 6 个月的投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动;

## 目 分析师声明

本报告署名分析师声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据, 特此声明。

## 目 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

国投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会核准, 取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告, 是证券投资咨询业务的一种基本形式, 本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值、投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布。

## 目 免责声明

本报告仅供国投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国投证券股份有限公司研究中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设，并采用适当的估值方法和模型得出的，由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性，估值结果和分析结论也存在局限性，请谨慎使用。

国投证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

### 国投证券研究中心

深圳市

地 址： 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 33 楼

邮 编： 518026

上海市

地 址： 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 3 层

邮 编： 200080

北京市

地 址： 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层

邮 编： 100034